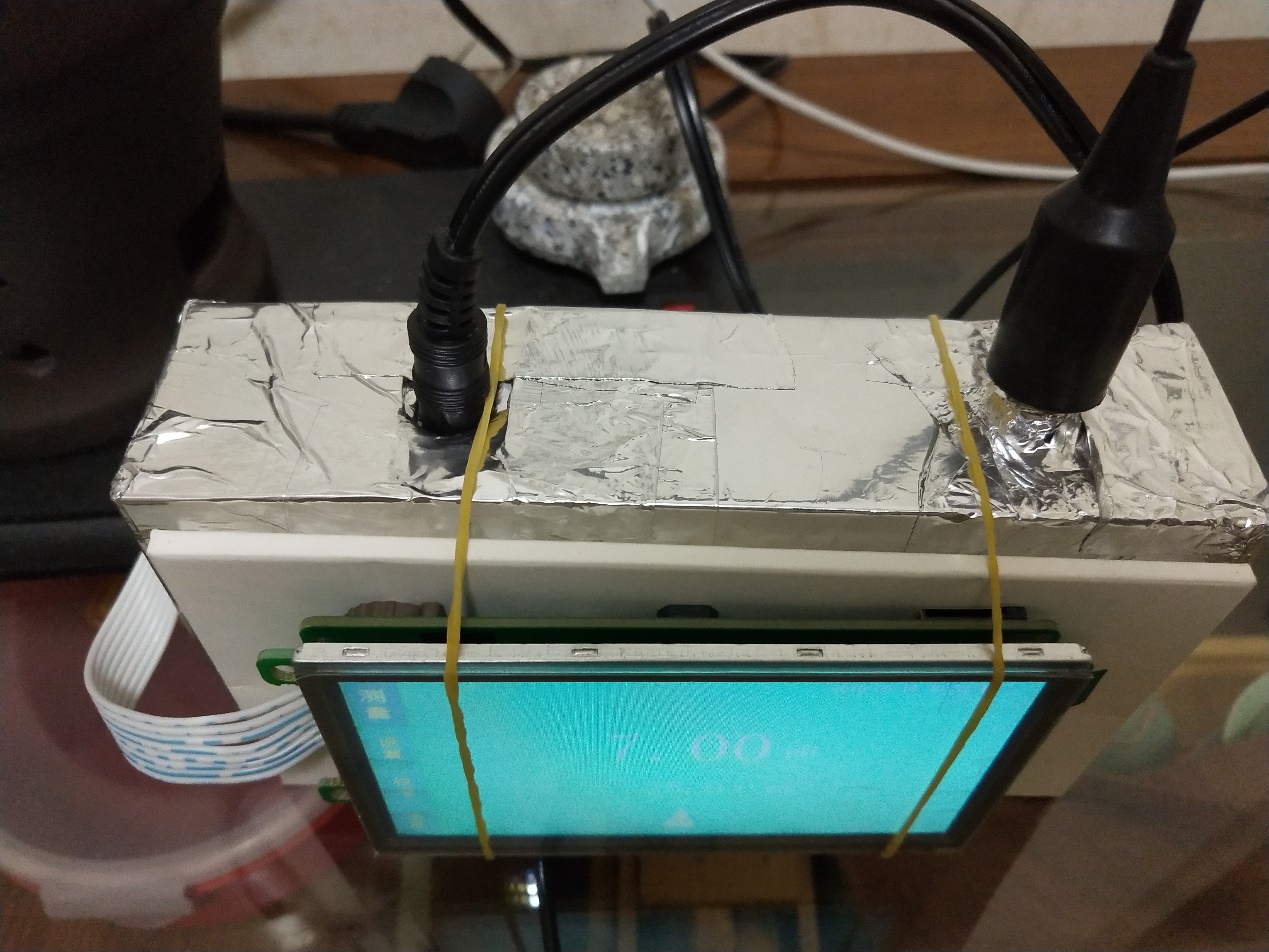
2019-06-17 To：老金

1. SPLab已经打样完成，如下：





1. 目前需要完善的几个地方
   1. INP输入端三个电容，C37和C32，不能焊接，如果焊接了高祖输入效果不好，现场版本焊接的没问题，我不知道什么原因，是不是PCB布线从电容中间过走线不好吗？
   2. 隔离5401芯片我觉得有必要继续加上去，性能会提高。
   3. 主板LCD连接器，需要调整到元器件同一面，现在焊接在底部，安装不方便，调整到和元器件同一层，引脚顺序正好反了